

MS-B760M I-CAFE

Specification

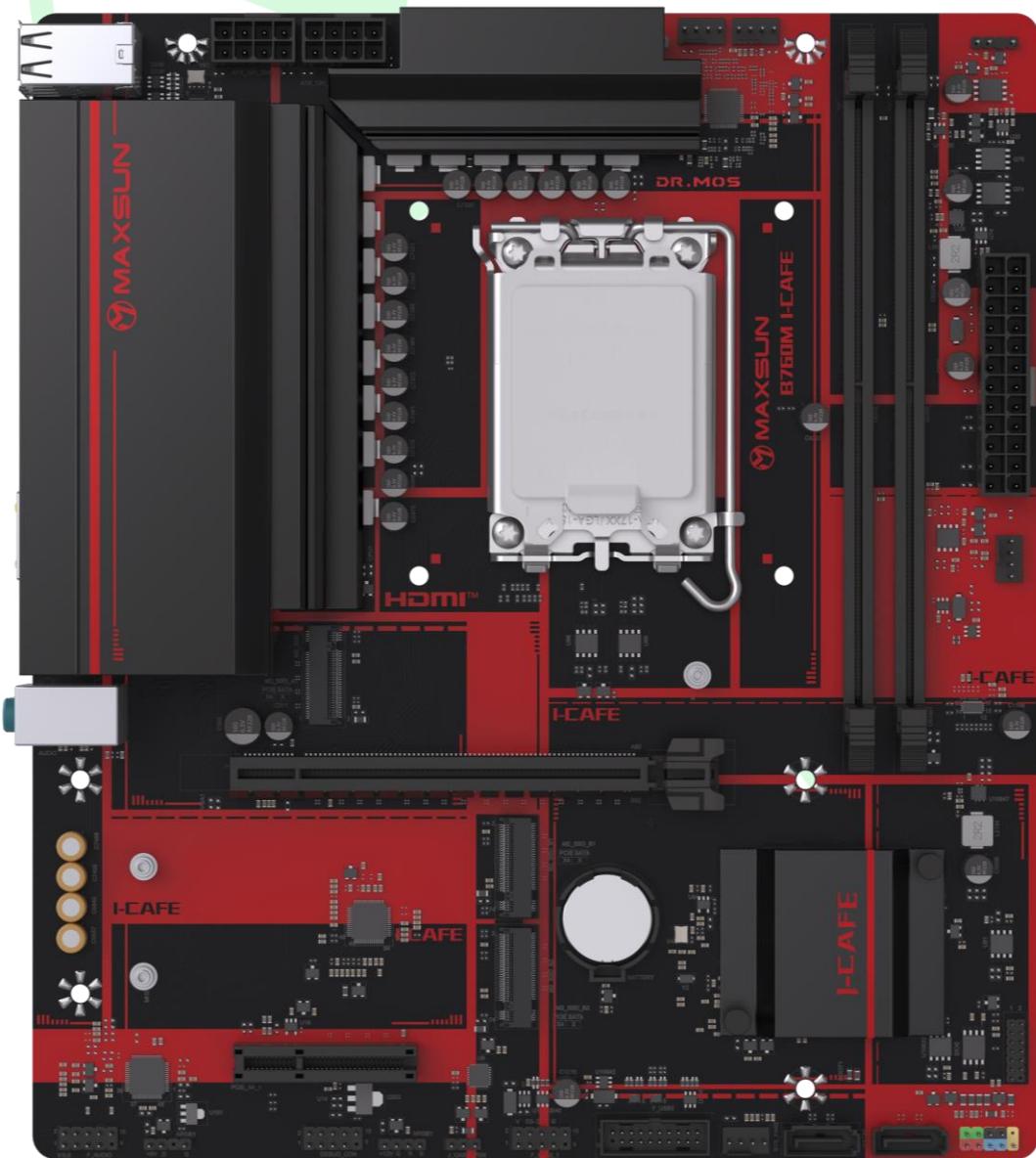
VER:A0

铭瑄科技
Maxsun Technology

Edit time : January 14, 2025

Editorial Department: Overseas Operations Department

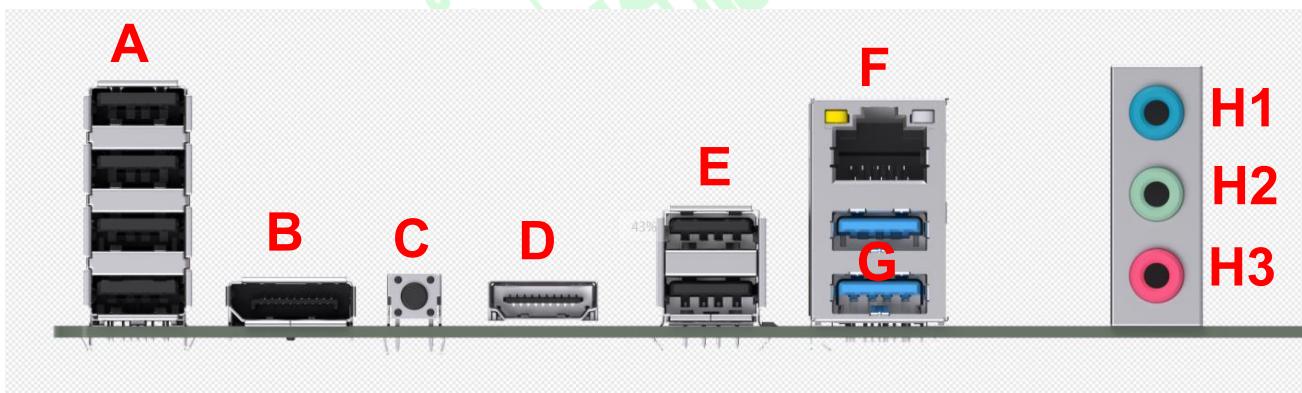
Chapter 1 Motherboard Configuration Diagram



(This image is for reference only. Some details may be adjusted according to the actual situation. Please refer to the actual product. Our company reserves the right of interpretation)

Size	MicroATX(245*210mm)
CPU	<p>LGA1700 slots are supported</p> <p>12th generation processors, 13th generation processors, 14th generation processors</p> <p>TDP: PL1:200W (12+1+1 Phase)</p> <p>PL2:253W</p>
Chipset	Intel®B760
Memory	<p>2 DIMM DDR5 memory slots</p> <p>Up to 96GB is supported</p> <p>Support dual channel memory technology</p> <p>Support 4800 MHZ or 5200 MHZ / 5600 MHZ, 6000 MHZ / 6400 MHZ /OC Memeroy frequency of memory</p>
Display	<p>Based on the display function of integrated graphics processor, shared display memory technology is adopted</p> <p>1 HDMI port, support up to 2560*1440@60Hz resolution (HDMI1.4 version)</p> <p>1 DP interface, up to 3840*2160@30Hz resolution (DP1.2 version)</p>
Pcie	<p>One PCIEX16 4.0 slot and one PCIEX4 3.0 slot</p> <p>Supports AMD and NVidia and INTEL independent graphics cards</p> <p>Supports PCIE resizable bar technology</p>
Audio	<p>Integrated ALC897 sound card chip</p> <p>Support the simultaneous output of the front and back channels</p> <p>Rear audio interface: 1 rear on-board LINE IN interface, 1 rear on-board LINE OUT interface, and a rear on-board MIC_IN microphone interface</p> <p>F_AUDIO pins: 1 set of front microphone pins, 1 set of front audio output pins (these 2 pins are F_Aduio pins)</p> <p>Needle set)</p> <p>1 set of 4pin horn BUZZER pins</p>
Network	<p>Integrated 1X Realtek RTL8125BG/D 2500Mb onboard RJ45 interface</p> <p>Support network wake-up</p> <p>Support PXE diskless, UEFI diskless boot</p>
Storage	<p>3 M.2 4.0 slots (supports 2242/2280 PCIE X4/X2 channel SSD)</p> <p>Two SATA3.0 interfaces</p>
USB	<p>Onboard rear interface: 2 USB3.2 GEN1 interface, 6 USB2.0 interface</p> <p>Board internal pins: 1 set (2) USB2.0 pins, 1 set (2) USB3.2GEN1 pins, 1 x USB 3.2Gen2 Type-C (10G) front interface</p>
In board socket	<p>1 24PIN motherboard ATX power supply interface</p> <p>1 8PIN motherboard ATX 12V power supply interface with 12V input</p> <p>2 sets of system fan pins, 1 set of CPU fan pins, 1 set of PUMP fan pins (all support intelligent fan adjustment except the PUMP pin)</p> <p>1 set of CLR_CMOS buttons</p> <p>1 Debug pin</p> <p>One 12V NRGB pin and two 5V ARGB pins</p> <p>1 set of front control panel pin (F_PANEL)</p>

Hardware monitoring	Voltage monitoring Temperature monitoring Fan monitoring Intelligent fan speed control (supported by the motherboard, intelligent fan speed control also requires fan support)
Operating system	Supports Windows10 64bit, Windows11 64bit Supports Ubuntu 64bit
ESD Protection	Air discharge ± 8KV C level ±6KV class B Contact discharge ± 6KV C level ± 3KV B class * Test the whole machine under the condition of good grounding
Packing Specification	Net weight: 680.6g Gross weight: 943.0g Color box size: 265*246*55mm Outer box size: 510*280*300mm FCL weight: 10.4kg



A: Double-layer USB3.2 GEN1 interface

It supports up to 5Gb speed transmission and is compatible with USB1.1 standard for connecting USB devices.

B: DP interface

Support up to 3840*2160@30Hz resolution, used to connect the display.

C: CLR_CMOS button

One key to clear the motherboard BIOS function Settings, restore the motherboard BIOS default initialization Settings.

D:HDMI interface

Support up to 2560*1440@60Hz resolution (HDMI1.4 version), used to connect to the monitor.

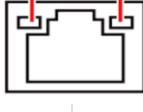
E: Double-layer USB2.0 TYPE A interface

It supports up to USB2.0 standard, and can be backward compatible with USB1.1 standard. Used to connect USB devices.

F: RJ45 interface

Network cable interface, used to access the network cable to link the host system to the network, the maximum bandwidth of 2500Mbps.

Activity Link LED		Speed LED	
Status	Description	Status	Description
Off	No link	Off	10Mbps connection
Yellow	Linked	Green	100Mbps connection
Blinking	Data activity	Orange	1000Mbps/2.5Gbps connection



G: Double-layer USB3.2 GEN1 interface

It supports up to 5Gb speed transmission and is compatible with USB1.1 standard for connecting USB devices.

H1: LINE IN interface (blue)

Used to receive audio input devices, such as mobile phone audio input.

H2: Audio-out interface (light green)

Used to access audio output devices, such as headphones, speakers and other external devices.

H3: Audio-Microphone interface (pink)

It is used to access audio input devices such as radio devices such as microphones.

MS-B760M I-CAFE

使用手册

VER:A0

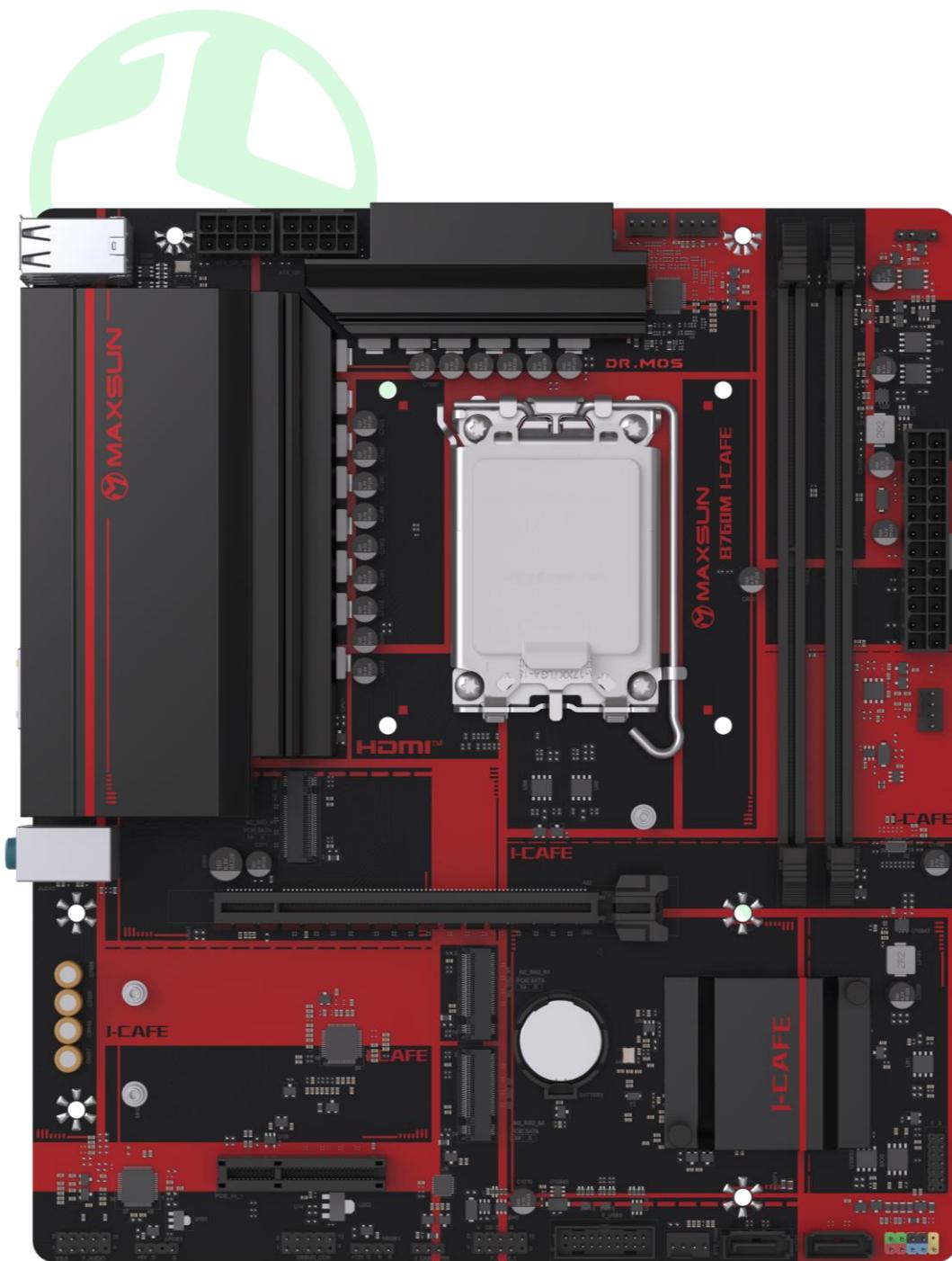


铭瑄科技
Maxsun Technology

编辑时间：2025年01月14日

编辑部门：商科集团技术部

第一章 主板配置图



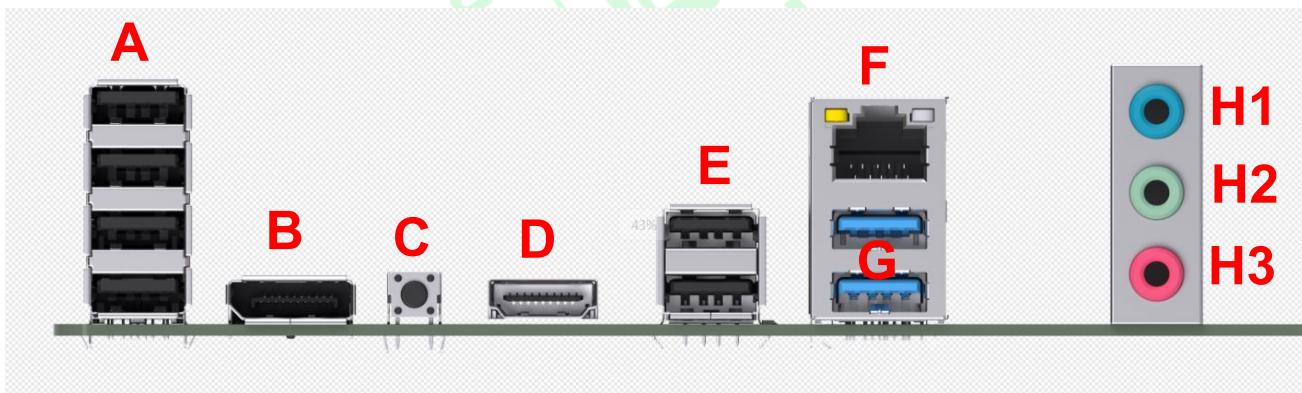
(此图仅供参考，部分细节会根据实际情况设计调整，请以实物为准，我司保留解释权)

第二章 规格

2.1、主板硬件规格

主板尺寸	MicroATX(245*210mm)
CPU	支持 LGA1700 插槽 第 12 代处理器、第 13 代处理器、第 14 代处理器 TDP: PL1:200W (12+1+1 项) PL2:253W
芯片组	Intel®B760 高速芯片组
内存	2 个 DIMM DDR5 内存槽 最高支持共 96GB 支持双通道内存技术 支持 4800MHZ/5200MHZ/5600MHZ/6000MHZ/6400MHZ/OC Memeroy 内存频率
显示	基于具备集成显卡处理器的显示功能，采用共享显示内存技术 1 个 HDMI 接口，最高支持 2560*1440@60Hz 分辨率 (HDMI1.4 版本) 1 个 DP 接口，最高支持 3840*2160@30Hz 分辨率 (DP1.2 版本)
扩展接口	1 个 PCIE X16 4.0 插槽，1 个 PCIE X4 3.0 插槽 支持 AMD 和 NVidia 和 INTEL 独立显卡 支持 PCIE resizable bar 技术
音频	集成 ALC897 声卡芯片 支持前后声道同时输出 后置音频接口：1 个后置板载 LINE IN 接口，1 个后置板载 LINE OUT 接口，一个后置板载 MIC_IN 麦克风接口 F_AUDIO 插针：1 组前置麦克风插针，1 组前置音频输出插针（此 2 个插针为 F_Audio 插针组） 1 组 4pin 喇叭 BUZZER 插针
网络	集成 1X Realtek RTL8125BG/D 2500Mb Ethernet 板载 RJ45 接口 支持网络唤醒 支持 PXE 无盘、UEFI 无盘引导
存储	3 个 M.2 4.0 插槽（支持 2242/2280 PCIE X4/X2 通道 SSD） 2 个 SATA3.0 接口
USB	板载后置接口：2 个 USB3.2 GEN1 接口，6 个 USB2.0 接口 板内插针：1 组（2 个）USB2.0 插针，1 组（2 个）USB3.2 GEN1 插针，1 x USB 3.2 Gen2 Type-C (10G) 前置接口
板内插座	1 个 24PIN 主板 ATX 供电接口 1 个 8PIN 主板 ATX 12V 供电接口，12V 输入 2 组系统风扇插针、1 组 CPU 风扇插针、1 组 PUMP 风扇插针（除 PUMP 插针外都支持智能风扇调节） 1 组 CLR_CMOS 按钮 1 个 Debug 插针

	1 个 12V NRGB 插针, 2 个 5V ARGB 插针 1 组机箱前置控制面板插针 (F_PANEL)
硬件监控	电压监测 温度监测 风扇监测 智能风扇控速 (主板已作支持, 智能风扇控速也需风扇支持)
操作系统	支持 Windows10 64bit, Windows11 64bit 支持 Ubuntu 64bit
ESD 防护	空气放电 ±8KV C 级 ±6KV B 级 接触放电 ±6KV C 级 ±3KV B 级 *整机接地良好的情况下测试
包装尺寸及重量	单板重量: 680.6g 单片彩包重量: 943.0g 彩盒尺寸: 265*246*55mm 外箱尺寸: 510*280*300mm 整箱重量: 10.3kg



A: 双层 USB3.2 GEN1 接口

最高支持理论 5Gb 速度传输, 可向下兼容 USB1.1 标准, 用于连接 USB 设备。

B: DP 接口

最高支持 3840*2160@30Hz 分辨率, 用于连接显示器。

C: CLR_CMOS 按钮

一键清除主板 BIOS 功能设置, 还原主板 BIOS 默认初始化设置。

D:HDMI 接口

最高支持 2560*1440@60Hz 分辨率 (HDMI1.4 版本), 用于连接显示器。

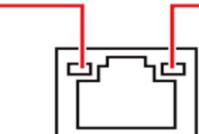
E: 双层 USB2.0 TYPE A 接口

最高支持 USB2.0 标准, 可向下兼容 USB1.1 标准。用于连接 USB 设备。

F: RJ45 接口

网线接口, 用于接入网线将主机系统链接到网络, 最高带宽 2500Mbps。

运行指示灯		速度指示灯	
状态	描述	状态	描述
关闭	无链接	关闭	10Mbps 连接
黄色	已链接	绿色	100Mbps 连接
闪烁	数据传输	橙色	1000Mbps/2.5Gbps 连接



G: 双层 USB3.2 GEN1 接口

最高支持理论 5Gb 速度传输, 可向下兼容 USB1.1 标准, 用于连接 USB 设备。

H1: LINE IN 接口(蓝色)

用于接收音频输入设备, 如手机音频输入。

H2: Audio-out 接口 (浅绿色)

用于接入音频输出设备, 如耳机、音箱等外放设备。

H3: Audio-麦克风接口 (粉红色)

用于接入音频输入设备, 如麦克风等收音设备。